

發明專利申請案第三方意見書

(本意見書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

◎提交意見時應一併提交本意見書、引證文件書目表及理由書。

※案由：21506
21508

一、申請案號：

(*應填寫發明專利案申請案號，如針對一案兩請而尚未公開之發明專利申請案提交意見，得填寫已公告之對應新型專利申請案號)

二、意見提交人：

(*意見提交人個人資料(身分)預設為不對外公開，所填具之電話僅供本局使用，請參閱經濟部智慧財產局履行個人資料保護義務告知事項)

姓名(公司名稱)：(中文/英文)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

國籍：(中文/英文)

電話及分機/傳真/手機：

意見提交人同意對外個人資料(身分)

(*本項勾選將公開提交人姓名、住居所或營業所地址及國籍)

三、附送書件：

(*注意事項：意見提交人已確認其所提交之文件不包含涉及提交人及他人之營業秘密、個人隱私或其他應保密之事項。)

1、引證文件書目表。

2、理由書。

3、引證文件資料。(非專利文獻者須提供)

4、公開日期證明文件。(引證文件非為專利文獻或期刊者須提供)

5、外文資料翻譯本。(非英文之外文資料者，須提供所引用文件段落之翻譯本)

6、其他：

四、個人資料保護注意事項：

意見提交人已詳閱提交須知所定個人資料保護注意事項，並已確認本意見書之附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；本意見書所附引證文件書目表、理由書等文件，任何人得依法申請閱卷，本局並將依法公開引證文件書目表。

※引證文件書目表將於專利公開資訊查詢系統中公開。

引證文件書目表

(引證文件書目表應作為附件與意見書一併提交)

(所提引證文件應依序以阿拉伯數字編號，各文件編號應與理由書所指稱文件編號一致)

一、專利文件：

專利文件				
文件編號	專利公開/ 公告號	專利名稱	公開日期	引用段落
引證__				
引證__				
引證__				

(表格列不敷使用時可自行新增列位)

二、非專利文件：

非專利文件					
文件編號	標題	作者	出版商或資 料來源	公開日期	引用段落
引證__					
引證__					

(表格列不敷使用時可自行新增列位)

A 式

理由書 (理由書應作為附件與意見書一併提交)		
申請案號		
引證文件與本案所請技術內容之關聯性		
文件編號	專利公開/公告號或非專利文件之標題	引證文件所揭露與本案申請專利範圍相關聯之具體內容
其他不具專利要件理由		

B 式

理由書 (理由書應作為附件與意見書一併提交)			
申請案號			
引證文件與本案所請技術內容之關聯性			
請求項	專利要件/法條	引證文件編號	技術特徵比對及不具專利要件理由論述
其他不具專利要件理由			